機械加工欠陥

# 1-8-2 めっき面付着粘性異物起因 (短絡) / 镀层面附着粘性杂物的起因(短絡)

/ Caused by foreign adhesive objects on plated surface(

#### 1-8-2-1 DFR スカム短絡/ DFR 余膜的短路/ Short by dry film scum

**【特徴**】めっき面のイレギュラー形状の短絡、単独 短絡だけでなく複数短絡も見られる

【特征】镀层上有不规则形状的短路,不仅有单独短路,而且有多处短路。

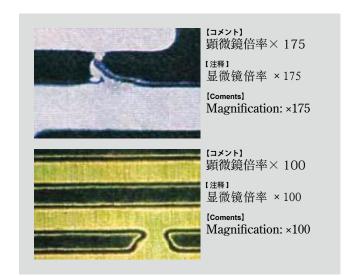
**[Characteristics]** Short in an irregular shape on the plated surface. More than one short is often seen.

【原因・判断ポイント・発生工程】基板めっき面に DFRスカムが再付着して、ETレジストとなった ことにより出来たもの(現像~ET工程)

【原因、判断要点、发生工序】DFR 余膜再次附着在 镀层面成为 ET 剂而引起的(显影~ ET 工序)。

### [Causes/processes involved/keys to judgment]

Dry film scum is adhered to the plated surface of a base material and acts as an etching resist, causing the defect. (Development - etching process)



#### 1-8-2-2 ヘドロ短絡/粘性污泥的短路 / Short by sludge

【特徴】銅めっき面のヘドロ状ベタ短絡

【特征】镀铜面附着粘性污泥的短路。

**[Characteristics]** Short of a wide area on the plated copper surface caused by sludge residue

【原因・判断ポイント・発生工程】現像工程で付着 したヘドロがめっき面に付着して、それが E T レジ ストとなった為できた短絡(現像~ E T 工程)

【原因、判断要点、发生工序】在显影工序发生的粘性污泥转移到电镀层,成为 ET 剂而引起的短路(显影~ ET 工序)。

## [Causes/processes involved/keys to judgment]

Sludge formed in development process adheres to the plated surface and acts an etching resist causing the defect. (Development - etching process)



「コメント」 顕微鏡倍率×

[注释] 显微镜倍率 ×

[coments] Magnification: ×



【コメント】 顕微鏡倍率×

<sup>【注释】</sup> 显微镜倍率×

[Coments] Magnification: ×